

300mm ウェーハ対応縦型炉 VF-5900

300mm Wafer Vertical Diffusion Furnace VF-5900



光洋リンドバーグ(株)では、300mm ウェーハ対応機としてVF-5900を開発、発売した。
ここに概要を紹介する。

型 式	: VF-5900	カセットストック数	: 12
ウェーハサイズ	: 300mm	プロセスカセット	: 8
外形寸法(W×D×Hmm)	: 1 200×2 750×3 350	ダミーカセット	: 2
バッチサイズ	: 100枚	モニターカセット	: 2
連続処理	: 2 バッチ	ウェーハ移載方法	: パキュームレス
常用使用温度	: 300 ~ 1 050	フィンガー	: 5 枚 + 1 枚
ヒータ	: LGO ヒータ	コントローラ	: Model1400
ヒータ均熱長(mm)	: 1 060	SECS対応	: 可能
温度制御	: 4 ゾーン	AGV対応	: 可能
		SMIF / FOUNDRY対応	: 可能

概要

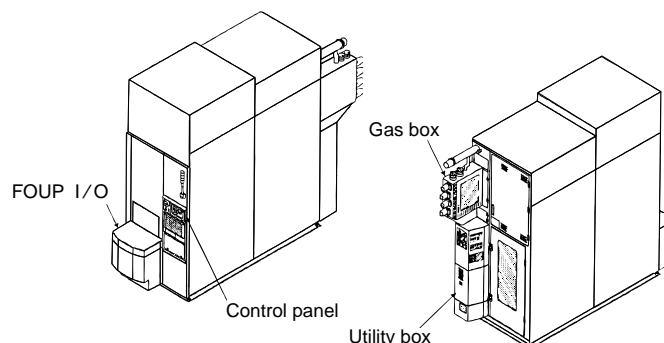
FOUP(25)を12個ストックでき、2 バッチ連続で各100枚の処理が可能。

I / OポートにセットされたFOUPは全てバッファ棚に搬送され、その後必要なFOUPのみ装置内のドアオープナーまで搬送されます。ウェーハは信頼性の高いツインアーム式スカラ型ロボットで、パキュームレス搬送されます。ポートはスリップを考慮したラダータイプを標準として採用。ヒータは定評のあるLGOヒータで、強制冷却システムを加えることにより更にスループットを上げることができます。

用途

- ・酸化 / 拡散 / アニール / 減圧CVD

外観図



特長

- ・量産型
最大100枚の処理を2バッチ連続で処理可能。
- ・新開発ヒータ
低温・高温とそれぞれのプロセスに合わせたヒータを搭載し、最適プロセスが実行可能。
- ・ロードロック
N₂ロードロックチャンバーにより、スループット向上に寄与する。
- ・操作性
世界標準に準拠した新型コントローラ Model 1400により操作性が向上。(HSMS, GEMに対応)
- ・メンテナンス
引き出し可能なFOUPバッファによりメンテナンスが容易。
- ・フットプリント
装置本体のみクリーンルームに設置し、補助機器は階下に設置可能とすることにより、フットプリントが縮小された。

光洋リンドバーグ株式会社